

公司代码：688372

公司简称：伟测科技



**上海伟测半导体科技股份有限公司  
关于本次募集资金投向  
属于科技创新领域的说明**

二〇二四年四月

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下：

## 一、本次募集资金投资项目概述

公司本次发行拟募集资金总额不超过 117,500 万元（含 117,500 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740	70,000
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000	20,000
3	偿还银行贷款和补充流动资金	27,500	27,500
合计		216,240	117,500

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## 二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

本次募集资金拟投资项目包括“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能；除此之外，公司拟使用剩余的募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析如下：

## **（一）“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”**

### **1、项目实施的必要性**

**（1）加码“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能建设，为我国集成电路测试的自主可控提供有力保障，助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展**

随着全球集成电路产业贸易冲突的加剧，集成电路测试的自主可控和国产化替代成为行业内企业的共同诉求。本次无锡和南京两个测试基地项目的建设，主要购置“高端芯片测试”所需的爱德万 V93000 EXA、爱德万 V93000、爱德万 T5830、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试机台近 200 台，以及“高可靠性芯片测试”所需的三温探针台、三温分选机和老化测试设备等设备近 200 台，大幅扩充“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的测试产能，缓解我国“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”相对紧张的局面，为我国集成电路测试的自主可控提供有力保障，最终助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展。

**（2）为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司的行业地位，强化“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势，不断缩小与国际巨头的差距**

自 2016 年成立以来，公司的业绩保持了高速增长的态势，截至目前，公司已经发展成为第三方集成电路测试领域规模最大的内资企业之一。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，通过本次无锡和南京两个测试基地项目的建设，能够进一步巩固公司的行业地位，强化公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势。本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司的测试服务能力、营业收入和净利润规模，不断缩小公司与全球最大的 3 家台资巨头的差距。

### **2、项目实施的可行性**

**（1）本次投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障**

本次募投项目投资于“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”两个方向，“高端芯片测试”优先服务于高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、的测试需求，“高可靠性芯片测试”优先服务于车规级芯片、工业级芯片的测试需求。上述芯片主要应用于各类旗舰级终端产品、人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、智能装备等领域，代表着未来的科技和消费发展方向，具有市场容量大、增速高的特点，为项目的实施提供了市场保障。

### **（2）公司拥有经验丰富、专业能力过硬的经营和技术团队，为项目的实施提供了人才保障**

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”有着丰富的实践经验和技能积累，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力，为本项目的实施提供了人才保障。

### **（3）公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”具有多年成功经验，积累了一大批高质量的客户，为本次项目的实施提供了客户保障**

在高端芯片测试领域，公司自 2018 年以来开始大力引进高端测试机台，将经营重心向高端测试和高端客户倾斜，2023 年度高端测试占公司业务收入的比例超过 75%，公司已经成为中国大陆高端测试服务的主要供应商之一，服务的客户包括紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、比特大陆、复旦微电、安路科技、瑞芯微等一大批知名厂商。

在高可靠性芯片测试领域，公司较早地大规模引进了国内相对稀缺的三温测试设备，并于 2021 年底在无锡筹备建立专业的老化测试生产线。公司在高可靠性芯片测试领域的技术实力、装备优势获得了大量车规级、工业级客户的认可，服务的客户包括地平线、合肥智芯、兆易创新、中兴微电子、复旦微电、国芯科技、杰发科技、禾赛科技等一大批知名厂商。

综上，公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”具有多年成功经验，积累了一大批高质量的客户，能够为本次项目的实施提供客户保障。

## **(二) 偿还银行贷款及补充流动资金**

### **1、项目实施的必要性**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 10,330.23 万元，长期借款余额为 47,726.36 万元，一年内到期的非流动负债余额为 14,835.30 万元，有息负债总额超过 7 亿元，偿债压力较大。此外，最近三年，公司营业收入分别为 49,314.43 万元、73,302.33 万元和 73,652.48 万元，年均复合增长率超过 20%。随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求，优化资本结构、减轻财务负担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保障。

### **2、项目实施的可行性**

#### **(1) 公司内控完善，募集资金管理相关制度规范**

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专项储存、使用作出了明确的制度安排，以在制度上保证募集资金的规范使用。

#### **(2) 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合法律法规的规定**

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。本次发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动资金的总金额为 27,500 万元。除此以外，本次募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”中包含的预备费及铺底流动资金，属于非资本性支出。上述金额合计占募集资金总额的比例未超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

## **三、募集资金投资项目的具体情况**

### **(一) 伟测半导体无锡集成电路测试基地项目**

#### **1、项目概况**

“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”的实施主体为全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司，总投资额为 98,740 万元，拟使用本次募集资金金额为 70,000 万元。本项目拟在无锡购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”相关机台，提升公司在上述两个方向的服务能力。

## **2、建设内容及投资概算**

本次募投项目之“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”的投资总额为 98,740 万元，拟投入募集资金 70,000 万元。

## **3、项目建设用地及项目备案、环评情况**

截至本说明出具日，公司已取得本项目建设地所属地块的不动产权证书，已完成项目备案的相关工作，环评手续正在办理过程中，预计后续取得环评批复不存在障碍。

# **(二) 伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目**

## **1、项目概况**

“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”的实施主体为全资子公司南京伟测半导体科技有限公司，总投资额为 90,000 万元，拟使用募集资金投资额为 20,000 万元。本项目拟在南京购置土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”相关机台，提升公司在上述两个方向的服务能力。

## **2、建设内容及投资概算**

本次募投项目之“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”的投资总额为 90,000 万元，拟投入募集资金 20,000 万元。

## **3、项目建设用地及项目备案、环评情况**

截至本说明出具日，公司已取得本项目建设地所属地块的不动产权证书，已完成项目备案和环评批复相关工作。

# **(三) 偿还银行贷款和补充流动资金**

公司综合考虑了自身经营状况以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 27,500 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，以缓解公司偿债压力、满

足公司资金需求，降低经营风险，保持公司持续、健康、稳定发展。

#### **四、本次募集资金投向科技创新领域的说明**

##### **（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明**

本次募集资金均用于公司主营业务集成电路测试领域。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），本次募投项目所属领域为“1新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.1集成电路”，属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，本次募投项目所属领域属于第四条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。

因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

##### **（二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式**

通过本次募投项目的实施，公司将进一步实现集成电路测试尤其是高端测试产能的扩张，进一步提升公司测试方案的开发能力，提高公司核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续提升。

未来公司将持续加大研发投入，重点针对车规级、工业类及高算力、复杂的SoC芯片的测试、大数据处理等方向，着重突破各类高端芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。

综上，本次发行是公司顺应行业发展趋势，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及相关领域开展，募集资金投向属于科技创新领域，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条第（四）条的相关规定。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日